
Leader in providing semiconductor test and inspection solutions
최고 기술력의 반도체 시험 · 검사장비 전문기업

TechWing

Disclaimer

본 자료에 포함된 향후 전망은 본사, 자회사 및 관계사 등에 대한 외부감사인의 회계감사나 검토가 되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

이 자료에 포함된 회사의 재무성과에 대한 모든 정보는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결 기준으로 작성되었습니다.

또한, 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"가 포함되어 있을 수 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.

"예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 이러 한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래 실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.



Leader in providing semiconductor test and inspection solutions

최고 기술력의 반도체 시험 · 검사장비전문기업

I. Company Overview

01. 회사 개요

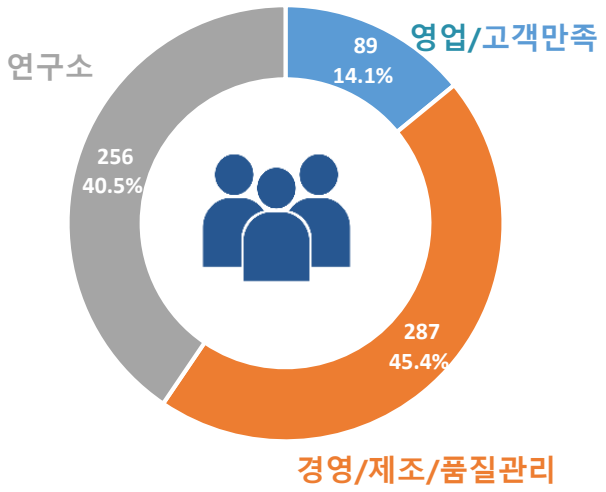
TechWing

글로벌 Top Tier 반도체 시험•검사장비 제공 전문기업

회사개요

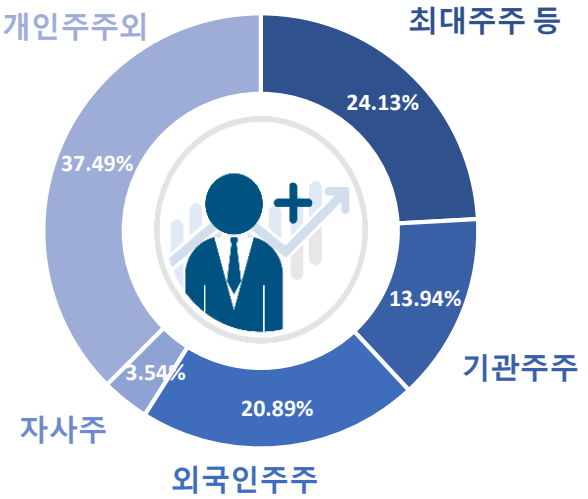
회사명	주식회사 테크윙
대표이사	나윤성, 장남
설립연도	2002년
자본금	190억원
사업영역	반도체 · 디스플레이 검사장비와 부품 등
홈페이지	https://www.techwing.co.kr
사업장	본사 : 경기도 화성시 동탄구 동탄산단 아산사업장 : 충남 아산시 음봉면
종속회사	1. ㈜이엔씨테크놀로지(지분율 53.6%) 2. ㈜에프에이에스(지분율 50.0%) 3. TechWing Malaysia SDN.BHD.(지분율 100%) 4. TechWing Vina Co.,LTD(지분율 100%)

인원현황



- 기준일 : 2026.09.30
- 총인원 : 632명

주주현황



- 기준일 : 2026.09.30
- 총발행주식수 : 37,053,645주

02. 주요 고객 현황

TechWing

다수 글로벌 반도체 기업 고객사로 확보! 제품다각화로 신규 고객사 확대!



03. 성장 연혁

TechWing

현재 Memory Test Handler 시장점유율 1위, SOC & HBM 사업확장
→ 반도체 Total Solution 제공 기업으로 지속 성장중

1 STEP 01 · 기초 다지기

설립 & 성장 2002 ~ 2009

Memory 핸들러 시장 진입 및 원천기술 확보

- **2002년**
  테크윙 법인 설립
- **2008년**
  세계 최초 128 PARA Test Handler 개발
- **2009년**
  세계 최초 512 PARA Test Handler 개발

기반: 메모리 검사장비 독자 개발

2 STEP 02 · 본격 도약

글로벌 점유율 1위 도약 2010~2013

글로벌 Memory Test Handler 시장 석권

- **2010년**
  Module Test Handler 공급
- **2011년**
  세계 최초 768 PARA Test Handler 개발

★ **2013년 : 사업 영역 대확장**
SoC Test Handler 진출
(메모리 → 비메모리 영역 확장)

성과: 메모리 핸들러 M/S 1위 등극

3 STEP 03 · 사업영역 확대 중

사업영역 확대 중 2014~2026+

HBM Cube Prober, Probe Station 등

- **2014년**
  SSD Test Handler 시장 진출
- **2020년 ~ 2021년**
  SSD Burn-in 검사장비 라인업 다각화
- **2025년**
  HBM Cube Prober 공급

FUTURE GROWTH ENGINE ★ 주력 미래동력

HBM Cube Prober & Probe Station &
차세대 Adv.Packaging Test 장비

"Package Test → Wafer Test & HBM Test &
차세대 Adv. Packaging Test 사업 영역 확장"

비전: 반도체 시험·검사장비 세계 최고 기업

04. Business Line-up

TechWing

기술 경쟁력을 통해 반도체 테스트 공정 내 다양한 사업 포트폴리오 구축

HBM-specialized Cube Prober



개별 HBM 전수검사 유일 Solution
시장 확대 및 매출 확대 중

SAMSUNG SK hynix Micron

Memory Test Handler



DRAM / NAND Test Handler
주요 매출 제품
세계 시장점유율 1위
차세대 제품 준비중

Micron SK hynix KIOXIA

TechWing

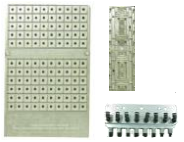
SOC Test Handler



SOC 반도체 Test Handler
Tri-Temp 기술 적용 제품
시장점유율 지속 확대중

Infineon SK hynix Amkor Technology

Etc equipment & Accessories



COK(Change over kit)



TIB(TechWing Interface Board)

Micron SK hynix KIOXIA

05. Technology Competence

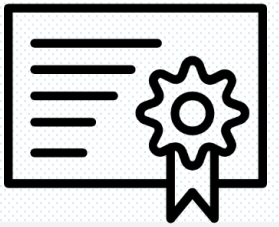
TechWing

20년 이상의 노력으로 인한 원천기술 확보

장비별 필요 Vision Align 정밀도

Memory Handler	SOC Handler	Cube Prober	Probe Station
• 100 ㎛	• 10 ㎛	• 3 ㎛	• 1.5 ㎛

지적재산권 보유 현황(2026.09.30기준)



932건

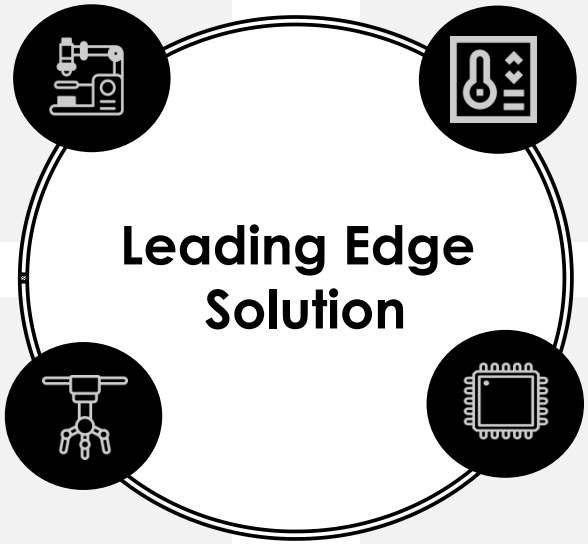
국내 및 해외 합계
(등록기준)

Vision Technology & Align Accuracy

Contact Accuracy 1㎛
Vision Auto Teaching
Loading Miss Detection
Pocket Leave Inspection
Damage Prevention

Temp Control

-55 ~ +150℃
±1℃ Accuracy
Active Thermal Control(ATC)
-80℃ Cryogenic temp Chiller



Small PKG Handling

Up to 2x2
Thin PKG

Fine Pitch High Para Contact

200㎛ Field proven with COK solution
50㎛ Field proven with Vision solution



Leader in providing semiconductor test and inspection solutions

최고 기술력의 반도체 시험 · 검사장비전문기업

II. Investment highlights

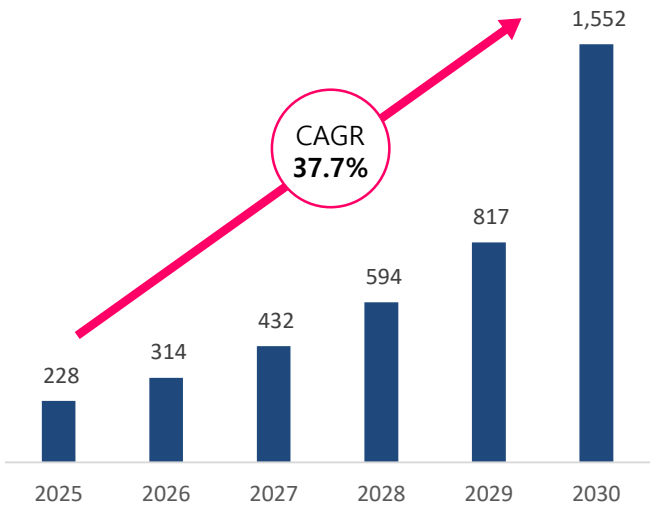
01. 시장 전망&기회

TechWing

테크윙은 "AI(37.6%) → HBM(30%) →반도체장비(7~8%)"의 성장 밸류체인 중심에 위치

AI 시장

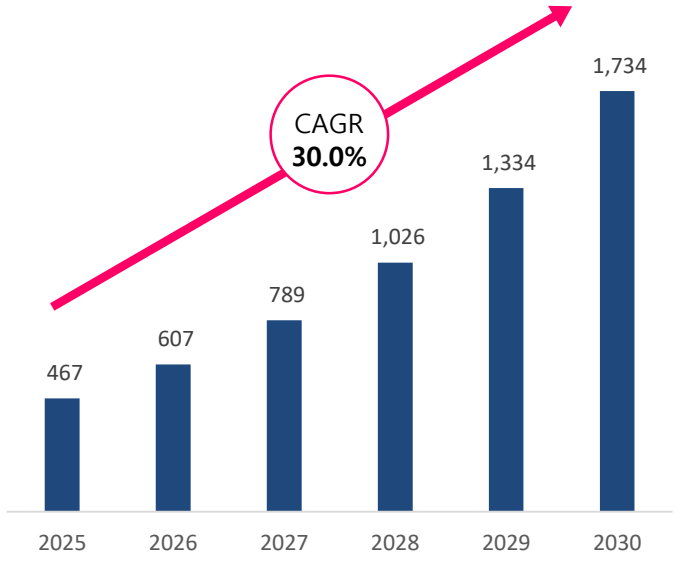
(단위 : 억 USD)



출처 : Grand View Research

HBM 시장

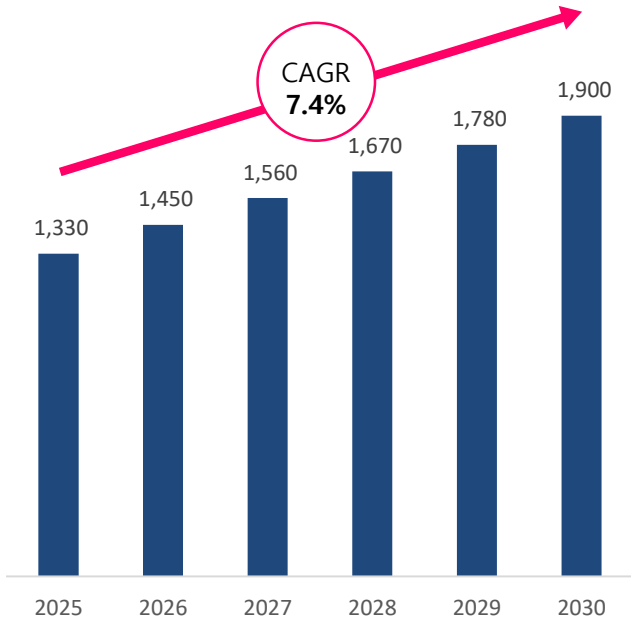
(단위 : 억 USD)



출처 : TrendForce

반도체 장비 시장

(단위 : 억 USD)



출처 : Semi
* 2028~2030년은 SEMI 전망 연장선상에서 시장 컨센서스 수준으로 추정

02. 글로벌 메모리 업체 Fab 투자 확대, 테크윙 수혜 기대

TechWing

Fab 증설 → 웨이퍼 및 메모리 칩 생산량 증가 → 패키징 검사 수요 확대 → 테크윙 수혜 기대

글로벌 메모리 업체 Fab 투자 확대

Micron

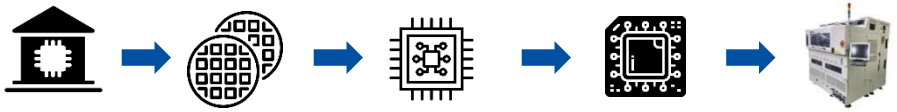
- 인도, 말레이시아, 싱가포르 Fab 투자지속
- AI서버향 HBM 투자지속

SK hynix

- 용인 Fab 등 메모리 생산라인 증설
- HBM 중심 메모리 CAPEX 확대

SAMSUNG

- 평택/해외 메모리 생산시설 확대
- HBM 및 첨단패키징 투자 강화



Fab 증설 (CAPEX 확대) → 웨이퍼 생산량 증가 → 메모리 칩 생산량 증가 → 패키징 테스트 물량 증가 → 검사장비 투자 확대

테크윙이 얻는 기회

01 메모리 생산 증가에 따른 메모리 핸들러 수요 증가

웨이퍼·메모리 생산 증가 → 검사 물량 확대

02 고객사의 정밀도·안정성이 높은 HBM 검사장비 채택 확대

HBM 고단화·고집적화 → 고성능 검사 수요 확대

03 고객사의 검사 자동화 및 설비투자 수혜 기대

AI 인프라 확장 → 고객사의 중장기 검사 투자 확대

03. Why Cube Prober? HBM4 이후 선택이 아닌 필수 검사 솔루션

TechWing

HBM4 이후 시장 Cube Prober 수요 확대 수혜 기대

AI 시대 도래 → HBM4 → HHBM4E → HBM5 → 고단화, 고집적화 → 불량 Cost 증가 → 전수검사 필요 확대 → Cube Prober 채택 가속화

Why Customers Choose Cube Prober

① CAPEX 절감

Test 효율성 극대화
→ 필요 설비 수량 감소
→ 고객사 투자비 절감
→ 생산성 향상

② OPEX 절감

설비 대수 감소
→ 전력 사용량 감소
→ 유틸리티 비용 절감
→ 유지보수 비용 절감

③ 품질 신뢰성 향상

100% 개별 Die 검사
→ 품질 신뢰성 향상
→ 고객 Brand Value 향상
→ End User 만족도 향상

Techwing Competitive Position

Global Memory Big3 대응

- 삼성전자에 양산 제품 공급 중, 수주량 증가중
- SK하이닉스 수주 확보, 수주량 증가 전망
- Micron 장비 평가 진행중

- **"HBM4E 이후에는 전수검사가 경쟁력이 아니라 필수 조건이 되며, Cube Prober는 이를 가장 경제적/효율적으로 구현할 수 있는 솔루션이다."**

04. Custom HBM 확대에 따른 개별 HBM 검사 중요성 증가

TechWing

Custom HBM의 기능 복잡도 증가 → Base Die IP·기능 검증 중요성 확대 → 완성 HBM 개별 Test 수요 확대 가능성

① NVHBM 구조 변화

NVIDIA Custom HBM

- Custom Base Die 적용
- Memory Controller / I/O PHY 등 맞춤형 IP 통합
- HBM 기능·성능 복잡도 증가

→ **Base Die IP 검증 중요성 확대**

② 검사 관점의 변화

현재 HBM 검증 구조

Base Wafer 위 DRAM Die 적층
↓
Wafer 위 적층 상태 Test
↓
개별로 HBM 절단
↓
개별 HBM 단위 품질·기능 검증

→ **개별 HBM Test 중요성 부각**

③ Cube Prober 기회

Cube Prober

완성된 HBM 개별 단위 Test

- 개별 HBM 단위 전수검사 대응
- 적층 완료 후 최종 제품 검증
- HBM 고도화 시 적용 확대 가능성

→ **Cube Prober 수요 확대 기회**

**HBM이 표준 제품에서 Custom HBM으로 진화할수록 Base Die IP 검증의 중요성이 높아지고,
완성된 HBM의 개별 단위 검사 필요성이 확대될 수 있음**

05. Advanced Packaging 시대 개화, DLP Handler 시장 진입 기대

TechWing

테크윙 Memory/Non-Memory DLP Handler 개발완료, 2028년초 시장 출시 예정

Market Trend & DLP Adoption

AI Expansion → HBM4 → HHBM4E → HBM5 → Chiplet Adoption → Advanced Packaging → Package Cost Increase → Known Good Die Importance → DLP Test Expansion

Why DLP?

과거	현재
Wafer Test → Packaging → Final Test → Shipment	Wafer Test → Die Singulation → DLP Test → Advanced Packaging → Final Test → Shipment

➡ 불량 Die를 제거하여 수율 향상 및 비용 절감

DLP Handler Value

- HBM 적층 증가 Known Good Die 확보 필수
- Chiplet Package Die 품질 확보 필요
- Advaced Packaging 공정 비용 증가
- DLP Handler 패키징 전 최종 선별

DLP Handler Market Outlook

2026~2030 CAGR	28~33%
시장성격	신시장
성장동력	HBM4, Chiplet, Advanced Packaging
시장단계	고성장 초기
2030 시장 규모	약 8~10억 달러

* 시장규모는 글로벌 Semiconductor Chip Handler 및 Test Handler 시장 데이터를 기반으로 추정

- HBM · Chiplet · Advanced Packaging 확산에 따라 DLP Handler는 차세대 검사 공정의 핵심 솔루션으로 부상
- 테크윙은 기존 글로벌 메모리 고객 기반을 바탕으로 DLP 시장 진입 및 신규 성장동력 확보 기대



Leader in providing semiconductor test and inspection solutions

최고 기술력의 반도체 시험 · 검사장비전문기업

III. Quarterly review

01. 3Q26 경영성과(잠정)

02. 2027년 전망

03. 최근 4개년 요약 연결재무제표

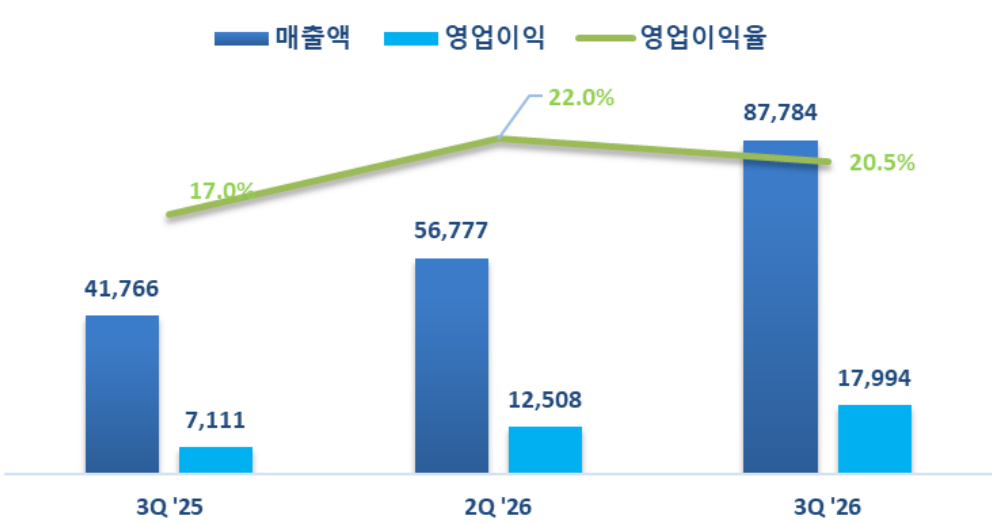
01. 경영성과

3Q26Y 실적(잠정)

(단위 : 백만원)

구분	3Q '26	2Q '26	3Q '25	QoQ	YoY
매출액	**87,784**	56,777	41,766	54.6%	110.2%
영업이익	**17,994**	12,508	7,111	43.9%	153.0%
영업이익율	**20.5%**	22.0%	17.0%	-1.5%P	3.5%P

(단위 : 백만원)



◆ **3Q26Y 실적 리뷰 및 향후전망**

- **매출 증가 : 메모리 시장 호황&고객사 후공정 투자 확대로 메모리 핸들러 수요 증가→전분기 및 전년 대비 매출 성장**
- **수익성 및 환율 영향 : 영업이익률은 전분기 대비 소폭 하락했으며, 전분기 대비 평균환율 약 80원 하락으로 환율 효과가 감소되어 영업이익률 약 1.5%p 하락**
- **향후 전망 : 글로벌 고객사의 메모리 Fab 및 패키지 투자 확대가 지속되며, 2026년 4분기~2027년까지 메모리 검사장비 수요 증가세 지속 전망**

03. 요약 연결재무제표

TechWing

요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년
유동자산	181,278	143,795	156,076	264,157
비유동자산	306,974	342,093	350,145	369,542
자산총계	**488,252**	**485,887**	**506,221**	**633,699**
유동부채	176,913	139,214	218,506	153,795
비유동부채	65,782	131,087	99,412	267,785
부채총계	**242,695**	**270,300**	**317,917**	**421,580**
[지배지분]	**231,610**	**216,902**	**190,752**	**215,076**
자본금	18,978	18,978	18,978	18,978
자본잉여금	39,758	39,758	39,758	39,758
이익잉여금	187,131	172,490	146,227	148,762
기타	(14,256)	(14,324)	(14,211)	7,578
비지배지분	13,948	(1,315)	(2,448)	(2,956)
자본총계	**245,558**	**215,587**	**188,303**	**212,120**

요약 연결손익계산서

(단위 : 백만원)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년
매출액	**267,491**	**133,604**	**185,507**	**159,128**
매출원가	158,044	84,056	114,022	91,933
매출총이익	**109,447**	**49,548**	**71,486**	**67,195**
영업이익	**57,673**	**3,160**	**23,411**	**15,838**
세전이익	42,737	(12,886)	(35,418)	7,526
법인세비용	9,499	1,789	(13,447)	(1,470)
당기순이익	**33,238**	**(11,097)**	**(21,970)**	**8,996**

감사합니다

“ 고객과 주주를 최우선으로
미래를 열어가는 테크윙이 되겠습니다. ”

TechWing